

Novoflex Pte Ltd 發佈顛覆行業的電訊行業 SIM 卡裝配流程

- 顯著簡化 SIM 卡的裝配流程並免去對基片的需求。
- 讓 SIM 卡製造商和網路業者實現顯著的成本節省
- 印度和印尼領先的行動網路業者發行透過新流程裝配的 SIM 卡
- 在全球獲得專利；全球各地的主要 SIM 卡供應商爭相認購

新加坡，2017 年 11 月 1 日 – 總部位於新加坡的智慧卡創新企業 Novoflex

今日公佈獲得專利的全新開創性流程 - Secure Authenticable Identification Laminates

(sAiL)TM，它重新定義了把積體電路 (IC) 晶片嵌入電訊行業目前使用的 SIM

卡中的方法。Novoflex 與印度智慧卡製造商 Eastcompeace 及印尼的製造商 CIPTA

合作，在這些國家的主要行動網路業者發行的 SIM 卡中使用積體電路 (IC) 晶片。

該流程不同於傳統的 SIM 卡製造方式，因為它免去了兩大步驟 -

模組封裝和模組嵌入。擁有靈活形式的 sAiLTM 採用塑料薄膜，有助於整合到一系列日常物品。

另外，由於在整個流程步驟中，需要使用的金更少，所以該新技術還能夠為 SIM

卡製造商顯著節省成本。由於流程與現有的製卡機器相容，sAiLTM 可直接整合於當前的智慧卡裝配流程。

Eastcompeace India Pvt Ltd 總經理 RajnishGiri 說道：「Eastcompeace

為最早採用創新的新技術和流程而感到驕傲。sAiLTM 展現了 SIM

卡生產流程的驚人飛躍。我們亦對在電訊行業以外運用 sAiLTM 的可能性感到興奮不已。」

CIPTA 執行長 Steven Chandra 表示：「我們在 CIPTA

的使命是利用創新向普通的個人賦予更大的力量在過去幾年裡，透過創新驅動，智慧卡應用已

滲透到各個行業。像 sAiLTM 這樣的技術可以改變行業遊戲規則，我們很高興能夠與 Novoflex

這樣的戰略夥伴合作，幫助我們打打造更加輝煌和燦爛的未來」

該流程已在 20

個國家成功獲得專利，目前在更多國家等待獲批專利；另外，該流程還引起了全球範圍內主要 SIM 卡供應商的興趣。儘管 sAiL™ 的最初需求來自電訊行業，但 Novoflex 已經在跟主要的行業參與者協同合作，將

sAiL™ 技術運用到銀行卡中，並相信其應用將在不久的將來擴大到交通和物聯網 (IoT) 領域。

Novoflex 執行長 Eric Ng 博士表示：「我們在 Novoflex

的使命是提供支援技術，讓產品更加智慧。sAiL™ 有助於實現安全驗證，儘管它目前的應用主要是在電訊行業，但這項技術的靈活性讓我們能夠預想比以往更寬廣的可能性。我們非常自豪能夠透過我們的合作夥伴在印度和印尼推出這種新技術，並且希望能夠快速向電訊行業以外擴展。」

關於 **Novoflex**

Novoflex

是一家總部位於新加坡的公司，主要專注於推動智慧卡行業的創新。該公司與由各類公司組成的生態系統建立合作夥伴關係，包括積體晶片製造商、支付公司、設備製造商、裝配和測試公司以及智慧卡供應商，推出其針對電訊、銀行和交通行業以及物聯網 (IoT) 領域應用的專利技術。

網站：www.novoflexglobal.com

媒體查詢：

Pang Sze Yong

Novoflex Pte Ltd

手機：65-90058567

sy.pang@novoflexglobal.com

K. Dorai Raja

ContentWerkz Pte Ltd

手機：65-97466010

電子郵件：raja@contentwerkz.com